

	△の数	訂正記事	担 当	検 図	年月日		△の数	訂正記事	担 当	検 図	年月日
△						△					
△						△					
適 用 規 格											
定 格	使用温度範囲	-55℃ ～ +105℃ (注1)				保存温度範囲	-10℃ ～ +60℃ (注3)				
	使用湿度範囲	20% ～ 80% (注2)				保存湿度範囲	40% ～ 70% (注3)				
	適合コネクタ	DF51K-30DS-2C(###)				電 流	AWG 30 : 0.5A AWG 28 : 1.0A AWG 26 : 1.5A AWG 22-24 : 2.0A				
	電 圧	100V AC/DC									
性 能											
項 目		試 験 方 法				規 格			QT	AT	
構造											
外観・構造・仕上げ		目視、寸法測定器にて測定する。				図面と合致していること。			○	○	
表示		目視にて確認する。							○	○	
電気的性能											
低電圧、低電流下の接触抵抗		20mV 以下、1 mA (DC又は 1000 Hz)で測定する。				30 mΩ 以下			○	-	
絶縁抵抗		DC 500 Vで測定する。				1,000 MΩ MIN.			○	-	
耐電圧		AC 500 Vの電圧を 1 分間印加する。				せん絡・絶縁破壊がないこと。			○	-	
機械的性能											
繰り返し動作 (Snメッキ)		30 回の抜き差しを行う。				①接触抵抗 : 30 mΩ 以下 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。			○	-	
繰り返し動作 (Auメッキ)		50 回の抜き差しを行う。				①接触抵抗 : 30 mΩ 以下 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。			○	-	
結合力及び離脱力 (Snメッキ)		適合コネクタで測定する。				①結合力 : 128.2 N以下 ②離脱力 : 7.7 N以上			○	-	
結合力及び離脱力 (Auメッキ)		適合コネクタで測定する。				①結合力 : 81.2 N以下 ②離脱力 : 7.5 N以上			○	-	
耐振性		周波数 10～55 Hz、片振幅 0.75 mmで 3 方向 各 10サイクル試験する。				①1 μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。			○	-	
耐衝撃性		加速度 490 m/s ² 、持続時間 11 ms、 正弦半波 3 軸両方向 各 3 回試験する。				①1 μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。			○	-	
環境的性能											
定常状態の耐湿性		温度 +40 ± 2℃、湿度 90～95 %中に 96 時間放置する。 (室温に1～2時間放置後測定)				①接触抵抗 : 30 mΩ 以下 ②絶縁抵抗 : 500 MΩ 以上 ③破損、ひび、部品のゆるみがないこと。			○	-	
備考 (注1) 通電時の温度上昇を含む。 (注2) 結露のないこと。 (注3) 基板搭載前の未使用品に対する長期保存状態に適用。 基板搭載後、輸送時の一時保管は使用温湿度範囲を適用。											
					製 図	担 当	検 図	承 認	リリース		
					J.S CHO	J.S CHO	S.M.LIM	S.M.LIM			
					21.05.14	21.05.14	21.05.14	21.05.14			
試験規格の記載のない試験方法はJIS C 5402を適用している。											
注 QT:確認試験 AT:製品検査 ○:適用項目											
HIROSE KOREA CO.,LTD.			製 品 規 格 表				製品名				
							DF51K-30DP-2H(800)				
コード* NO.(OLD)			図番.			製品コード*			1/2		
CL			JLC4-633522			CL 6652-0082-3-800					

温度サイクル	温度 -55 → 105℃ 時間 30 →30分 を 5 サイクル 試験する。 槽の移し換えは時間は2～3分 (室温に1～2時間放置後測定)	①接触抵抗：30 mΩ 以下 ②絶縁抵抗：1,000 MΩ 以上 ③破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
耐熱性	温度 +105 ± 2℃中に96時間放置する。	①接触抵抗：30mΩ 以下 ②絶縁抵抗：1,000 MΩ 以上 ③破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
耐寒性	温度 -55 ± 3℃中に96時間放置する。	①接触抵抗：30mΩ 以下 ②絶縁抵抗：1,000 MΩ 以上 ③破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
はんだ耐熱性	リフロー時間 リフローサイクル数:2サイクル。最大 220℃以上の60秒持続時間。最大 ピーク温度:250℃で10秒。最大	外観の変形及び端子等に著しいガタがないこと。	○	—
はんだ付け性	はんだ温度 245 ℃、浸せき時間 5 秒間の はんだ付けを行う。	はんだ浸せき面の95%以上が新しいはんだ でぬれていること。	○	—
推奨温度プロファイル	鉛フリークリームはんだ温度プロファイル(推奨) リフロー回数：2回 温度は端子リード部にて測定しています クリームはんだ種類、基板サイズ、その他の実装部材等の条件により、異なる場合がありますので、実装状態を十分にご確認の上ご使用願います。			

注 QT:確認試験 AT:製品検査 ○:適用項目				
HIROSE KOREA CO.,LTD.		製品規格表		製品名 DF51K-30DP-2H(800)
コード NO.(OLD) CL	図番. JLC4-633522	製品コード CL 6652-0082-3-800		2/2